

2003年5月14日

**エンタープライズサーバ「EP8000 690/670」に最新のプロセッサ POWER4+を搭載し、  
処理性能が大幅に向上した「POWER4+搭載モデル」を追加**

最大メインメモリ容量や I/O データ転送速度をそれぞれ 2 倍に増強



EP8000 690/670  
「POWER4+搭載モデル」

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:古川 一夫、以下 日立)は、このたび、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を搭載したエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」のハイエンドモデル「EP8000 690」、およびミッドレンジモデル「EP8000 670」において、現行の POWER4(1.3GHz/1.1GHz)を搭載したモデルに加えて、最新プロセッサの POWER4+を搭載した「POWER4+搭載モデル」をラインアップに追加し、5月16日から販売開始します。

最新プロセッサ POWER4+を「EP8000 690」では最大 32 個(1.7GHz/1.5GHz)、「EP8000 670」では最大 16 個(1.5GHz)を搭載することが可能です。また、基本機能においても、現行の POWER4 搭載モデルに比べ、最大メインメモリ容量やデータの入出力を行う I/O バスの I/O データ転送速度をそれぞれ 2 倍に増強しました。これにより、OLTP(On-line Transaction Processing)(\*1)性能において「EP8000 690」で最大約 1.6 倍、「EP8000 670」で最大約 1.9 倍と処理性能が大幅に向上しました。

\*1) OLTP(On-Line Transaction Processing) : オンライン業務で関連する複数の処理を一つの処理単位にまとめて管理する方式。

本製品は、性能を向上しながらも価格は現行機とほぼ同等に据え置いており、中規模業務システムから大規模データベースシステム、データウェアハウス、OLTP システムといった大規模基幹システムまでの様々なニーズに、より幅広く対応できるシステム構築環境を、優れたプライスパフォーマンスにて提供します。また、業務拡大やデータ量の増大などに伴うシステム拡張にも柔軟に対応します。

さらに障害発生の予防や障害時の迅速なシステム復旧を支援するための運用支援サービスやサポートサービスを強化して高可用性(障害回復・対策機能)を実現します。

今回のモデル追加は、ユーザーがリソースをコアビジネスに集中し、高信頼性かつビジネスの変化に即応した最適なシステムを構築できる環境を提供する日立のサービスプラットフォームコンセプト Harmonious Computing に基づいています。

### 本製品の概要

モデル	形状	プロセッサ	プロセッサ数	キャッシュメモリ	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 690	ラックマウント	POWER4+ (1.5/1.7GHz)	8,16,24,32	レベル 2 キャッシュ : 1.5MB (2 プロセッサあたり)	8GB ~ 512GB	標準 20 (最大 160)
EP8000 670		POWER4+ (1.5GHz)	4,8,16	レベル 3 キャッシュ : 32MB (1または2 プロセッサあたり)	4GB ~ 256GB	標準 20 (最大 60)

### 本製品の価格及び出荷時期

モデル	標準価格	出荷開始時期
EP8000 690 POWER4+(1.7GHz)	1億 1,436 万円 ~	2003 年 6 月 30 日
EP8000 690 POWER4+(1.5GHz)	9,861 万円 ~	
EP8000 670 POWER4+(1.5GHz)	4,554 万円 ~	

### 製品情報のホームページ

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000>

### 他社所有商標に関する表示

- ・AIX、IBM、POWER4/POWER4+は米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

### 本件に関するお問合せ先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ  
 エンタープライズサーバ事業部 企画部【担当:喜多村】  
 〒259 - 1392 神奈川県秦野市堀山下1番地  
 TEL : 0463 - 87 - 6786(ダイヤルイン)

以上

## EP8000 690/670 「POWER4+搭載モデル」の特長

### 1. 最新の POWER4+プロセッサを採用し、処理性能を強化

「EP8000 690」はプロセッサを SMP(\*1)構成で最大 32way まで搭載可能なハイエンドクラスの、また「EP8000 670」はプロセッサを SMP 構成で最大 16way まで搭載可能なミッドレンジクラスのラックマウント型サーバです。今回、「EP8000 690」および「EP8000 670」に最新の POWER4+プロセッサを搭載し、処理性能の大幅な強化を行いました。

POWER4+は、64bit マルチプロセッサチップである POWER4 を改良し、処理性能を強化した最新プロセッサです。POWER4 と同様に最新のプロセッサ製造技術である銅配線技術および SOI(\*2)技術を採用し、加えて線幅 0.13 マイクロメートルの最新半導体プロセスにより製造されることで、動作周波数を最大 1.7GHz まで向上しています。

今回「EP8000 690」には 1.7GHz 及び 1.5GHz を、また「EP8000 670」には 1.5GHz の POWER4+を採用しており、現行の POWER4 を搭載したモデルに比べ OLTP 性能で「EP8000 690」は最大約 1.6 倍、「EP8000 670」は最大約 1.9 倍の性能向上を実現しました。

\*1) SMP: Symmetric Multi-Processor

\*2) SOI: Silicon on Insulator

### 2. 最大メモリ容量及び I/O データ転送速度を現行の 2 倍に増強

処理性能の強化に加え、現行の「POWER4 搭載モデル」に対しメインメモリの最大容量を 2 倍に増強しました。「EP8000 690」では最大 512GB、「EP8000 670」では最大 256GB まで増設可能です。また、データの入出力を行う I/O バスの I/O データ転送速度(I/O スループット)も現行の 2 倍(「EP8000 690」: 最大 32GB/秒、「EP8000 670」: 最大 12GB/秒)に強化しました。拡張 PCI(\*3)スロットは、高速な PCI-X 規格に準拠しており、「EP8000 690」では最大 160 スロット、「EP8000 670」では最大 60 スロットまで増設することが可能です。

\*3) PCI: Peripheral Component interconnect

### 3. 「EP8000 690」の動的論理分割機能(Dynamic LPAR)を強化

「EP8000 690/670」はシステムのリソースを動的に複数のパーティションに割り当てることができる動的論理分割機能をサポートしています。今回「EP8000 690」の動的論理分割機能について、パーティション数を最大 32 に強化しました。

「EP8000」の論理分割機能では、プロセッサは 1 個単位、メモリは 256MB 単位、拡張 PCI スロットは 1 本単位で各パーティションに割り当てることができ、ユーザーニーズに合せたきめ細かいリソース分割設定が可能です。

論理分割した各パーティションは、それぞれが OS を含めて独立したシステム装置の様に使用可能です。各パーティションで動作するソフトウェア製品が論理分割機能を意識する必要はなく、豊富な AIX 用アプリケーションがそのまま利用することが可能です。

動的論理分割機能により、業務の種類や処理量に応じたシステムリソースの有効活用や、予測を超える業務量拡大だけでなく、計画的なハードウェア構成変更などにも柔軟に対応します。

#### **4. メインフレームクラスの高信頼性と高可用性をあわせ持つ設計**

「EP8000 シリーズ」は高信頼性・高可用性(障害回避・対策機能)を追求したハードウェア設計となっています。「EP8000 690/670」は、プロセッサやキャッシュメモリのエラーが一定回数を超えた場合にそのプロセッサを自動的に切り離し他プロセッサで処理を継続する動的プロセッサ切り離し機能、PCI バスあるいは PCI アダプタ障害によるシステムリブートを回避し、システムの処理を続行する PCI バス障害リカバリ機能・動的 PCI アダプタ切り離し機能などの高度な高信頼・高可用(障害回避・対策機能)機能を備えています。これらの機能によりシステム停止につながる障害発生を大幅に低減し、安心して利用できるシステムを提供します。

#### **5. 最新のソフトウェア環境を提供**

現行の「POWER4 搭載モデル」と同様、オペレーティングシステム(OS)として IBM 社の UNIX オペレーティングシステム AIX 5L を採用しています。優れたパフォーマンス、高信頼性・高可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能を提供します。

ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェアに加え、DBMS(\*4)製品 Oracle<sup>R</sup>や SAP<sup>R</sup> R/3<sup>R</sup>を含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com<sup>R</sup>など豊富な ISV(\*5)製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステム構築が可能です。

\*4) DBMS: Database Management System

\*5) ISV: Independent Software Vender

#### **現行「EP8000 シリーズ」も含めた高信頼運用支援機能/サポートサービスの強化**

今回のモデル追加にあわせて、現行の「EP8000 シリーズ」も含めた高信頼運用支援機能と高信頼サポートサービスのメニューを新たに強化しました。

#### **1. 高信頼運用支援機能強化**

ユーザーシステムのハードウェアをリモートで監視し、サービス停止やシステムダウンの回避や障害時の迅速なシステム復旧を支援する遠隔保守機能を強化しました。今回の機能強化により、システムをよりきめ細かに監視し、予兆管理することが可能となります。(2003 年 5 月 30 日から提供開始)

- ・ 詳細ログの解析を自動化することにより異常値検出の精度を高める「詳細ログ自動解析」
- ・ 冗長部位の状況を常に監視することにより、冗長性が失われた場合に迅速な回復を支援する「冗長部位エラーモニタリング」
- ・ 日立ディスクアレイサブシステムSANRISEの状況をEP8000から監視し、障害発生時に自動通報、ドライブ閉塞など迅速な対応を実現する「SANRISE自動通報」

#### **2. 高信頼サポートサービス強化**

ミッションクリティカルな業務システムを長期にわたり安心して利用可能な環境を提供する高度サポートサービスのメニュー強化を行いました。これにより、システム障害に対してさらに迅速な対応が可能となります。(2003 年 7 月 31 日から提供開始)

- ・ ユーザーシステムのシステムダンプをサポートサービスセンタからリモートで解析。大量となるシステムダンプをサポートサービスセンタに送付する必要がなくなり、障害要因の解析開始までの時間を大幅な短縮を実現しました。

「EP8000 シリーズ」は、「オープン & ミッションクリティカル」をコンセプトに、今後も積極的な高信頼性・高可用性の強化を推進します。

#### **他社所有商標に関する表示**

- ・ AIX、IBM、POWER4/POWER4+は米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・ Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・ Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems Inc.の商標または登録商標です。
- ・ ORACLE は、ORACLE Corporation の登録商標です。
- ・ SAP R/3®、mySAP.com は、SAP AG のドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・ UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

## 新製品の仕様

モデル		EP8000 690 「POWER4+搭載モデル」
形状		ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ	POWER4+
	クロック・レート (GHz)	1.5/1.7
	プロセッサ数 (way)	8, 16, 24, 32
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.5 (2プロセッサあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		32 (2プロセッサあたり)
主記憶容量	最小～最大(GB) *1	8～512
内蔵ディスク容量	最小～最大(GB) *2	36～2,348 (I/Oドローアあたり)
拡張PCIスロット本数		20 (I/Oドローアあたり)
I/Oドローア数		1～8
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドローア	560×990×757 (17EIA *3)
	I/Oドローア	560×860×178 (4EIA *3)
	搭載筐体	790×1,443×2,027 (1ラック構成) 1,540×1,443×2,027 (2ラック構成)
電源		200～240V (三相)
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率 *4	0.083 *5
	区分	F

モデル		EP8000 670 「POWER4+搭載モデル」	
形状		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ	POWER4+	
	クロック・レート (GHz)	1.5	
	プロセッサ数 (way)	4	8, 16
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.5 (1プロセッサあたり)	1.5 (2プロセッサあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		32 (1プロセッサあたり)	32 (2プロセッサあたり)
主記憶容量	最小～最大(GB) *1	4～256	
内蔵ディスク容量	最小～最大(GB) *2	36～2,348 (I/Oドローアあたり)	
拡張PCIスロット本数		20 (I/Oドローアあたり)	
I/Oドローア数		1～3	
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドローア	560×990×757 (17EIA *3)	
	I/Oドローア	560×860×178 (4EIA *3)	
	搭載筐体	790×1,443×2,027 (1ラック構成)	
電源		200～240V (単相または三相)	
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率 *4	0.122 *5	
	区分	F	

\*1: 1MB(メガバイト)=1,024<sup>2</sup>バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024<sup>3</sup>バイトです。

\*2: 1GB(ギガバイト)=1,000<sup>3</sup>バイトです。

\*3: ラック搭載時の占有サイズ(1EIA=高さ約44.5mm)

\*4: 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を, 省エネ法で定める複合理論性能で除した値

\*5: POWER4の数値です。

---

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

---